

Title (en)  
Contact pin for solderless fixing in plated through holes of printed circuits

Title (de)  
Kontaktstift zur lötfreien Befestigung in metallisierten Löchern von Leiterplatten

Title (fr)  
Broche de contact à fixer dans des trous métallisés de circuits imprimés

Publication  
**EP 0942490 A2 19990915 (DE)**

Application  
**EP 99104701 A 19990310**

Priority  
DE 19810897 A 19980313

Abstract (en)  
The contact pin has a curved bridge with a deeper trough (26) on its concave side. The distance between two contact zones (24) in the half of a press-in section (14) contg. the lower shoulder is greater than the distance between two contact zones in the half contg. the shallower trough. The straight axis-parallel contact zone is 0.5 mm. +/- 20 per cent long. The width of the end surface (32,36) near the base is smaller than the width of the base surface between the side surfaces (34). The contours of the base surfaces of both troughs are at least approximately geometrically similar.

Abstract (de)  
Ein Kontaktstift (10) weist einen elastisch verformbaren Einpreßabschnitt (14) mit einem sich zur Stiftkuppe (18) sich verjüngenden Einführabschnitt (16) auf. Beiden Abschnitten (14, 16) sind zwei einander diametral gegenüber liegende Mulden zugeordnet. Zwischen beiden Mulden wird eine dünne gebogene Brücke gebildet. Beide Mulden weisen acht Umfangsflächenteile auf und sind unterschiedlich tief ausgebildet. Die tiefere Mulde (26) hat zwei lange schrägliegende Verbindungsflächen (33) zwischen der kuppenseitigen Stirnfläche (32) und den achsparallelen Seitenflächen (34) sowie zwei schaftseitige schräg zur Schaftachse angeordnete Verbindungsflächen (35) zwischen den Seitenflächen (34) und der schaftseitigen Stirnfläche (36). Die tiefere Mulde ist tropfenförmig und die gegenüberliegende flachere Mulde ist ovalförmig konturiert. Im Einpreßabschnitt werden vier exakt achsparallele Kontaktzonen (24) mit einer Länge von 0,50 mm gebildet, die einen zentrischen Klemmsitz in einem Loch (50) einer Leiterplatte 52 von nur 0,8 mm Plattenstärke ermöglichen. Der verjüngte Einführabschnitt (16) liegt etwa zur Hälfte im Leiterplattenloch und schafft einen Spanraum für verdrängtes Zinn. Ein Auslaufabschnitt (17) des Stiftes (10) liegt ebenfalls etwa zur Hälfte im Leiterplattenloch (50) und ermöglicht einen Druckknopfeffekt. <IMAGE>

IPC 1-7  
**H01R 9/09**

IPC 8 full level  
**H01R 12/58** (2011.01)

CPC (source: EP)  
**H01R 12/585** (2013.01)

Cited by  
CN111755858A

Designated contracting state (EPC)  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

DOCDB simple family (publication)  
**DE 19810897 C1 19990819**; EP 0942490 A2 19990915; EP 0942490 A3 20020102

DOCDB simple family (application)  
**DE 19810897 A 19980313**; EP 99104701 A 19990310